Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM 200 GB 60 DLC

eupec

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

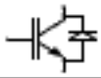
Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T_C= 50°C T_C= 25°C	$I_{C nom.}$ I_C	200 230	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_P= 1ms, T_C= 50°C	I_{CRM}	400	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T_C= 25°C, Transistor	P_{tot}	730	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	200	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	t_P= 1ms	I_{FRM}	400	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	V_R= 0V, t_P= 10ms, T_{vj}= 125°C	I^2t	4.050	A^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f= 50Hz, t= 1min.	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	I_C= 200A, V_{GE}= 15V, T_{vj}= 25°C I_C= 200A, V_{GE}= 15V, T_{vj}= 125°C	$V_{CE sat}$	- -	1,95 2,20	2,45 -	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	I_C= 4,0mA, V_{CE}= V_{GE}, T_{vj}= 25°C	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f= 1MHz, T_{vj}= 25°C, V_{CE}= 25V, V_{GE}= 0V	C_{ies}	-	9	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f= 1MHz, T_{vj}= 25°C, V_{CE}= 25V, V_{GE}= 0V	C_{res}	-	0,8	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V_{CE}= 600V, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 25°C V_{CE}= 600V, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 125°C	I_{CES}	- -	1 1	500 -	µA mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V_{CE}= 0V, V_{GE}= 20V, T_{vj}= 25°C	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: Andreas Vetter	date of publication: 2000-04-26
approved by: Michael Hornkamp	revision: 1



Charakteristische Werte / Characteristic values

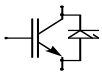
Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	I_C= 200A, V_{CC}= 300V V_{GE}= ±15V, R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 25°C V_{GE}= ±15V, R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 125°C	$t_{d,on}$	- -	163 180	- -	ns ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I_C= 200A, V_{CC}= 300V V_{GE}= ±15V, R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 25°C V_{GE}= ±15V, R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 125°C	t_r	- -	43 49	- -	ns ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	I_C= 200A, V_{CC}= 300V V_{GE}= ±15V, R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 25°C V_{GE}= ±15V, R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 125°C	$t_{d,off}$	- -	253 285	- -	ns ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I_C= 200A, V_{CC}= 300V V_{GE}= ±15V, R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 25°C V_{GE}= ±15V, R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 125°C	t_f	- -	33 41	- -	ns ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I_C= 200A, V_{CC}= 300V, V_{GE}= 15V R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 125°C, L_σ= 15nH	E_{on}	-	4,6	-	mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I_C= 200A, V_{CC}= 300V, V_{GE}= 15V R_G= 1,5Ω, T_{vj}= 125°C, L_σ= 15nH	E_{off}	-	6,3	-	mJ
Kurzschlußverhalten SC Data	t_P ≤ 10µsec, V_{GE} ≤ 15V T_{vj}≤125°C, V_{CC}=360V, V_{CEmax}= V_{CES} -$L_{\sigma CE}$ ·di/dt	I_{SC}	-	900	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	40	-	nH
Modul-Leitungswiderstand, Anschlüsse - Chip lead resistance, terminals - chip	T_C= 25°C	$R_{CC'+EE'}$	-	0,9	-	mΩ

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	I_F= 200A, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 25°C I_F= 200A, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 125°C	V_F	- -	1,25 1,20	1,6 -	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F= 200A, -dI_F/dt= 4000A/µsec V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 25°C V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 125°C	I_{RM}	- -	154 188	- -	A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	I_F= 200A, -dI_F/dt= 4000A/µsec V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 25°C V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 125°C	Q_r	- -	12,1 19,7	- -	µC µC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F= 200A, -dI_F/dt= 4000A/µsec V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 25°C V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 125°C	E_{rec}	- -	- 4,1	- -	mJ mJ



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC Diode / diode, DC	R_{thJC}	- -	- -	0,17 0,29	K/W K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ_{Paste}= 1W/m*K / λ_{grease}= 1W/m*K	R_{thCK}	-	0,02	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

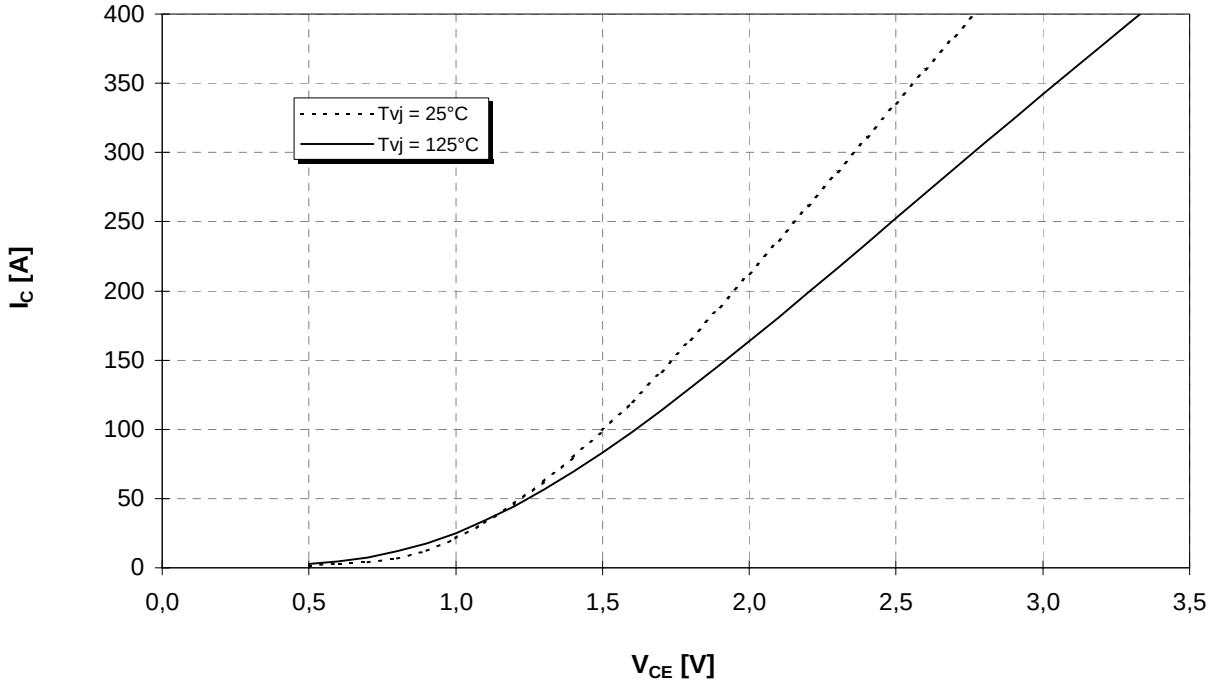
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix						
Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3		
Kriechstrecke creepage insulation				15		mm
Luftstrecke clearance				8,5		mm
CTI comperative tracking index				275		
Anzugsdrehmoment für mech. Befestigung mounting torque	Schraube M6 screw M6	M1		5		Nm %
			-15		+15	
Gewicht weight		G		180		g

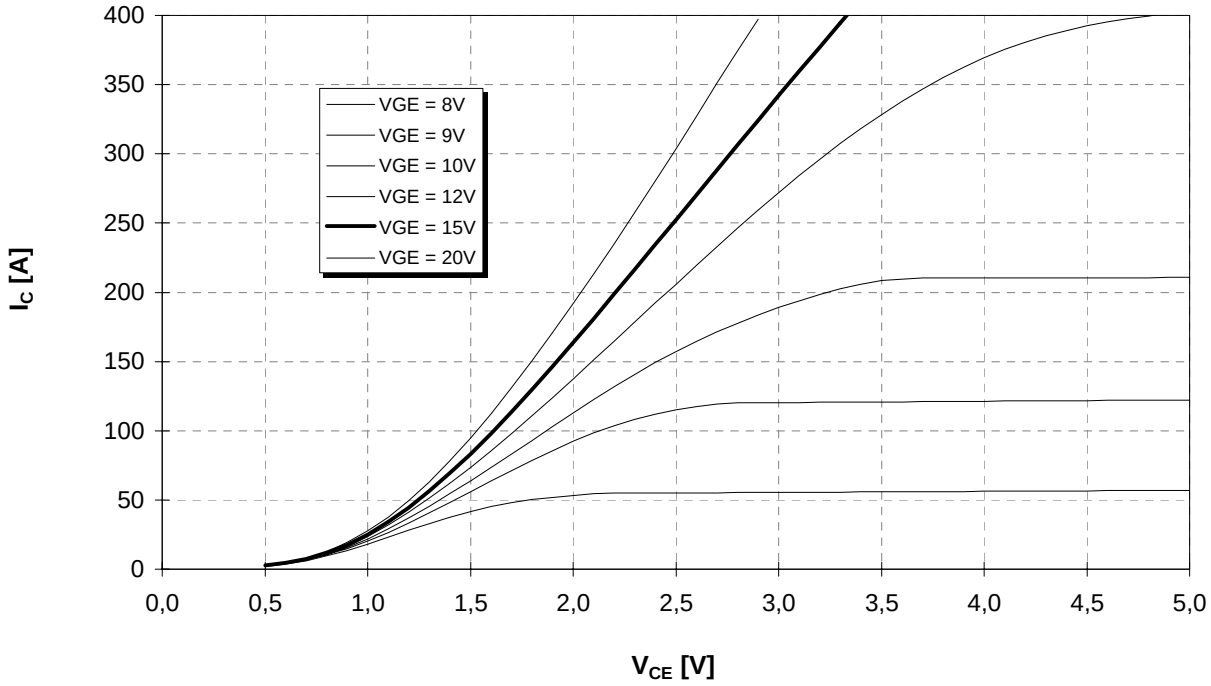
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics.
It is valid in combination with the belonging technical notes.

Ausgangskennlinie (typisch) $I_C = f(V_{CE})$
Output characteristic (typical) $V_{GE} = 15V$

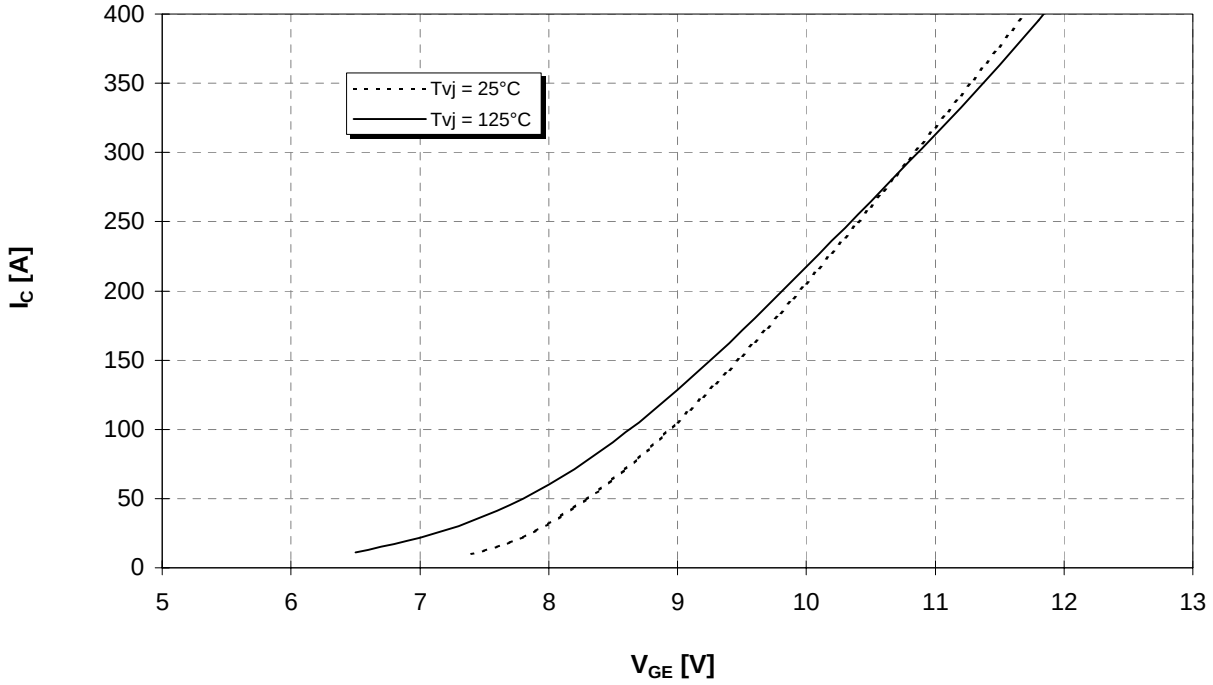


Ausgangskennlinienfeld (typisch) $I_C = f(V_{CE})$
Output characteristic (typical) $T_{vj} = 125°C$



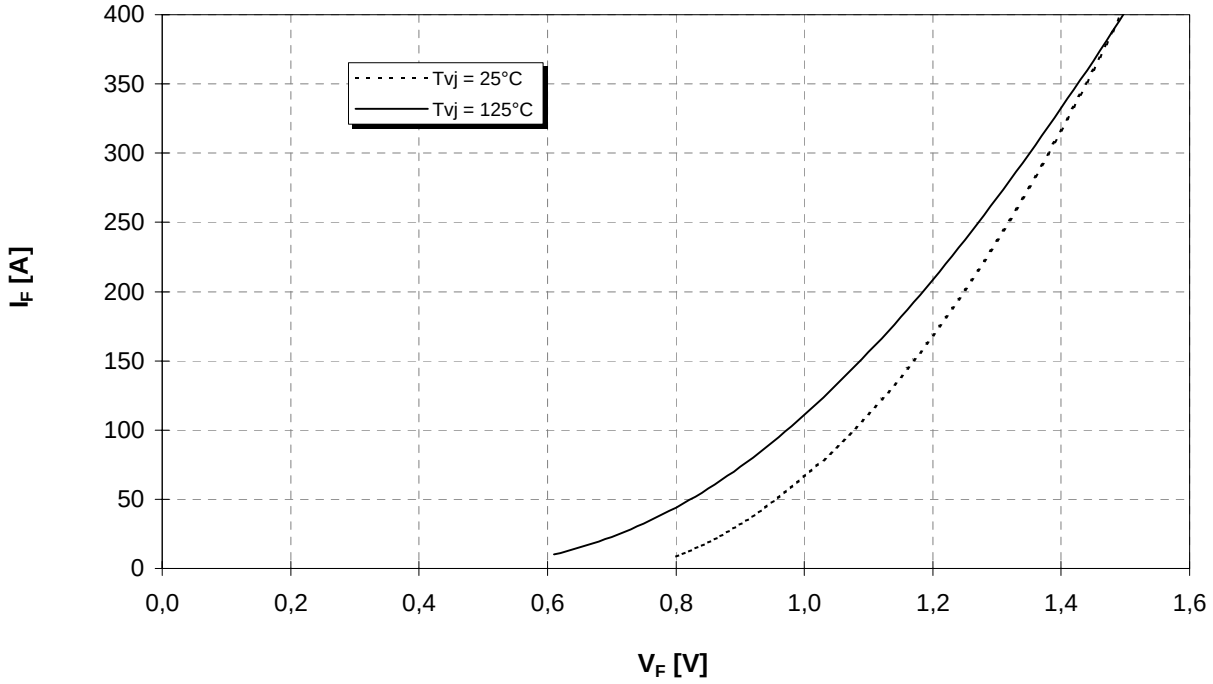
Übertragungscharakteristik (typisch) $I_C = f(V_{GE})$

Transfer characteristic (typical) $V_{CE} = 20V$



Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch) $I_F = f(V_F)$

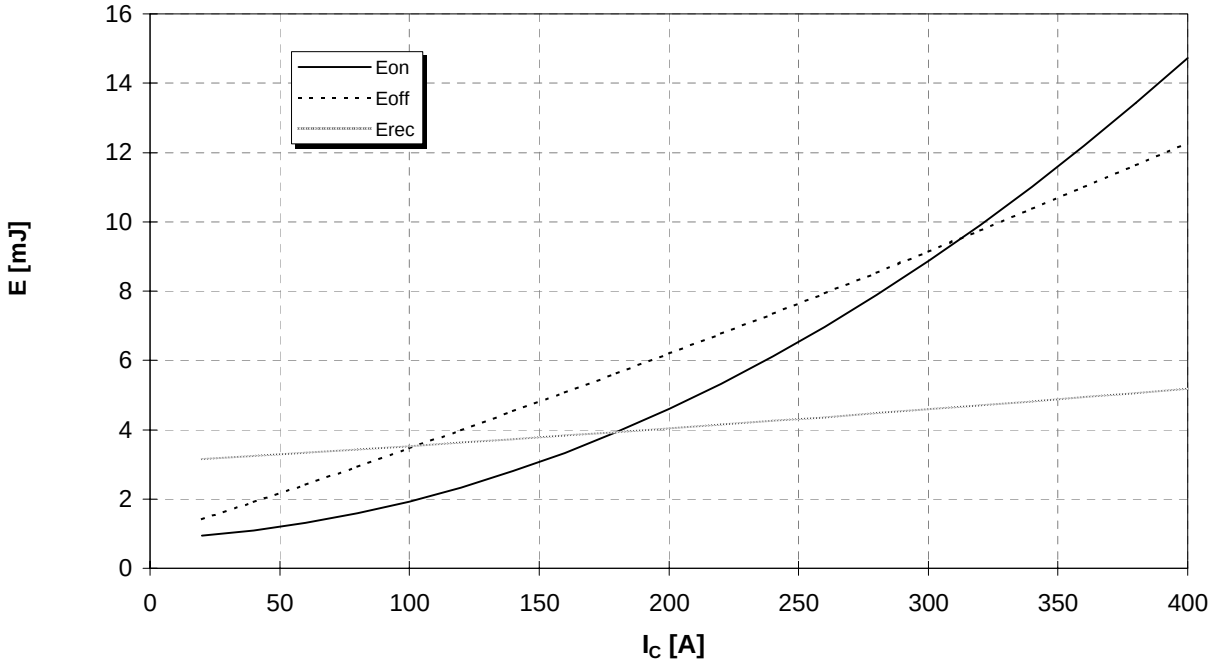
Forward characteristic of inverse diode (typical)



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$

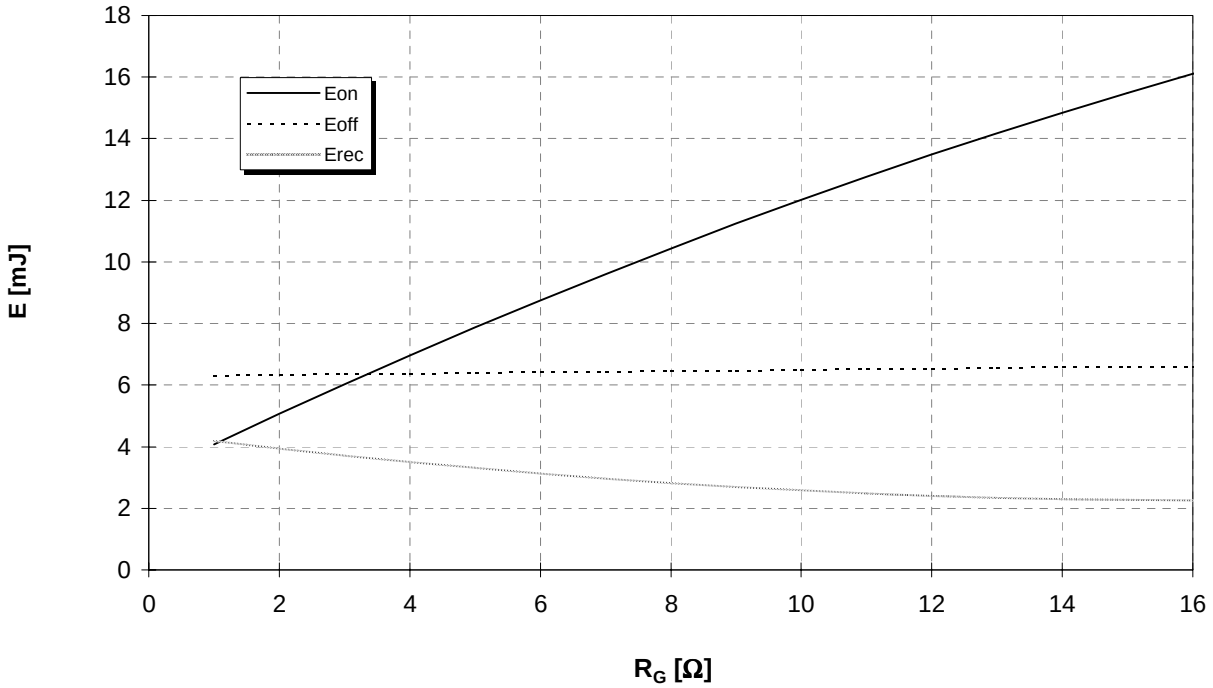
$R_{G,on}$= 1,5Ω, $R_{G,off}$= 1,5Ω, V_{CC}= 300V, T_{vj}= 125°C



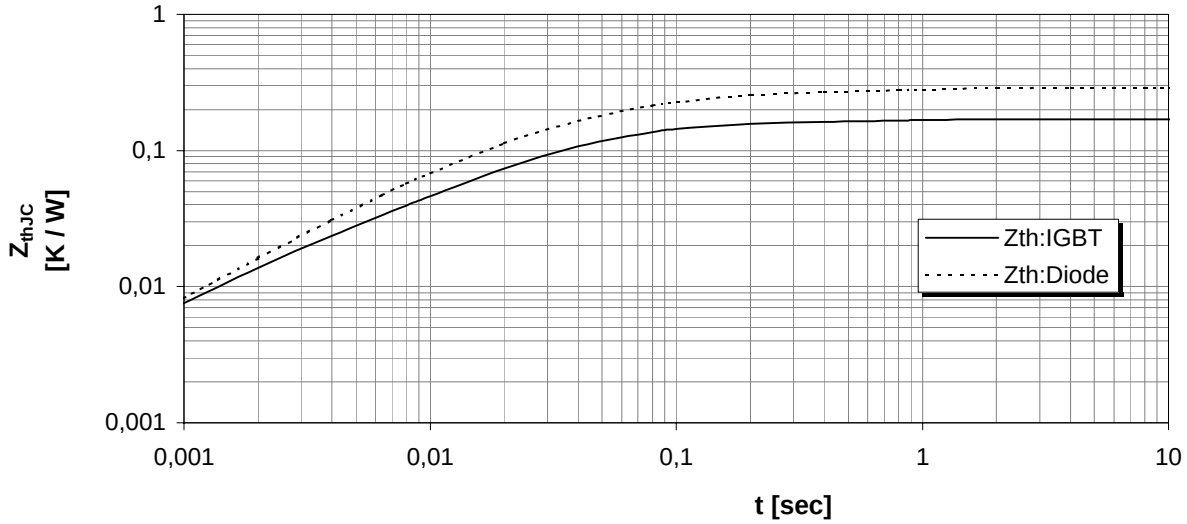
Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$

I_C= 200A , V_{CC}= 300V , T_{vj} = 125°C

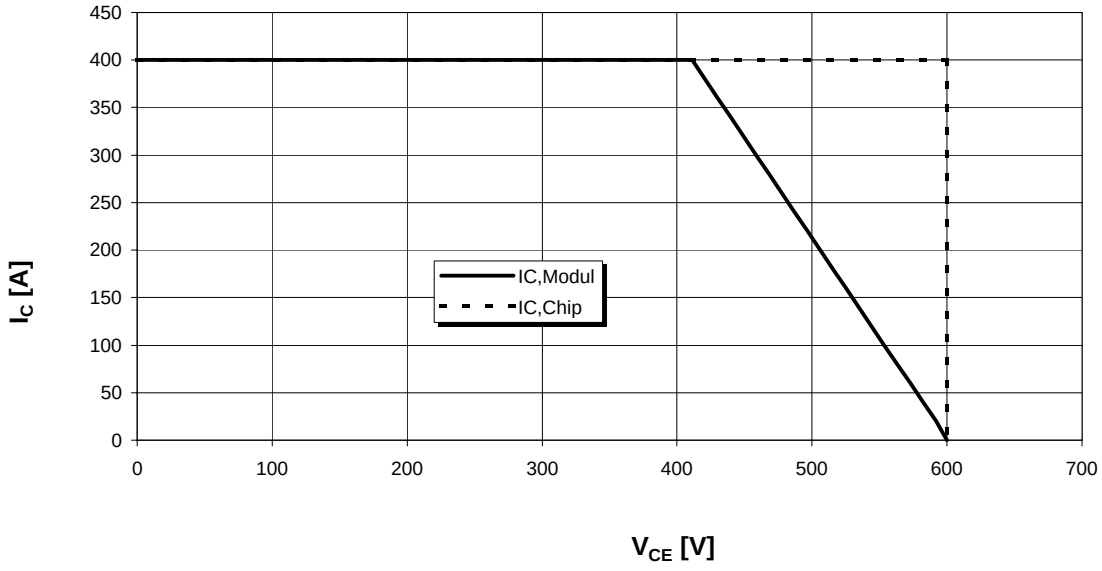


Transienter Wärmewiderstand $Z_{thJC} = f(t)$
Transient thermal impedance

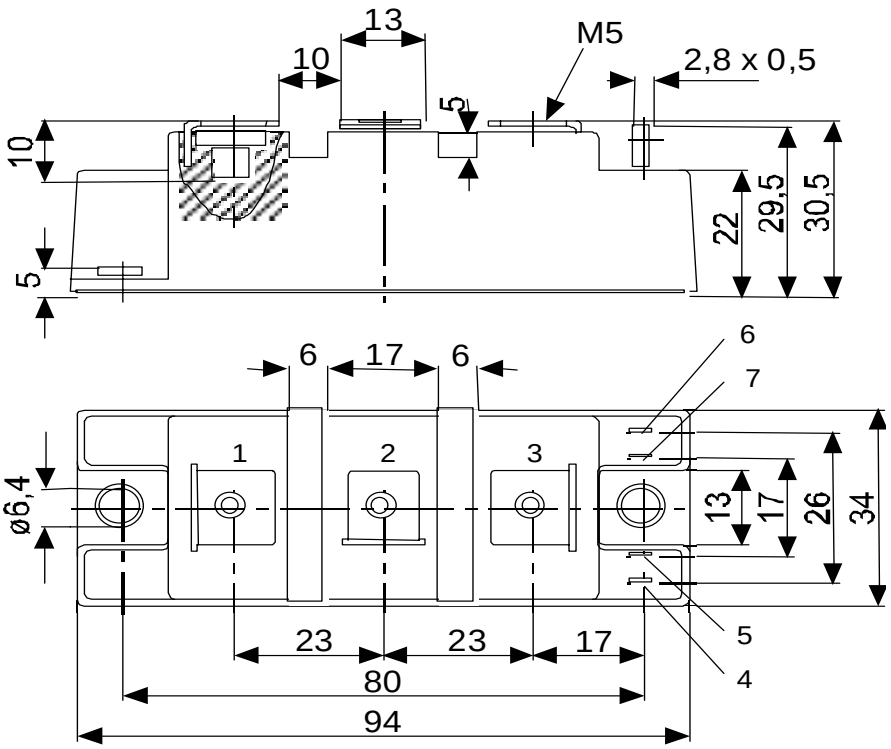


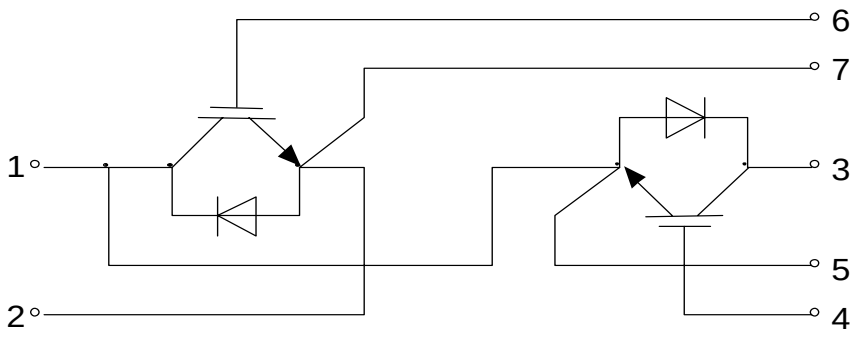
i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	7,2	89,1	59,9	13,8
τ_i [sec] : IGBT	0,0018	0,0240	0,0651	0,6626
r_i [K/kW] : Diode	102,2	98,0	61,6	28,2
τ_i [sec] : Diode	0,0487	0,0169	0,1069	0,9115

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
Reverse bias safe operation area (RBSOA) V_{GE}= +15V, $R_{G,off}$= 1,5Ω, T_{vj}= 125°C



Gehäusemaße / Schaltbild
Package outline / Circuit diagram





LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru